

Investor Relations

Your Most Trustworthy



유의 사항

Disclaimer

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

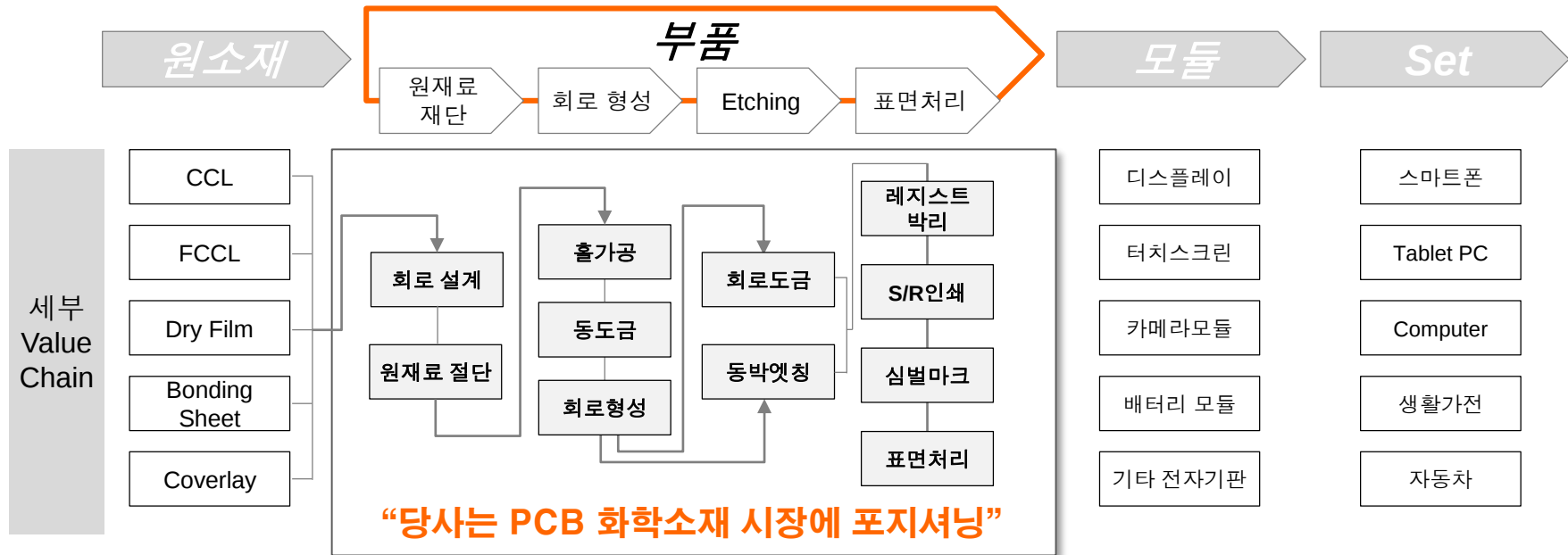
또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

와이엠티는 전자소재 산업에서 반드시 필요한 **화학소재를 직접 개발 / 제조 / 납품하는 회사**로써, 모바일 뿐만 아니라 전기자동차, 웨어러블 디바이스, 바이오 센서 등에서도 그 가치를 인정받고 있습니다.

- ✓ 주요 표면처리 분야 : 무전해금도금 프로세스 [Soft ENIG / ENIG / ENEPIG] , 무전해 화학동, 프로세스 케미컬
- ✓ 주요 고객사 : 영풍전자, 삼성전기, 비에이치, ZDT 등



YMT Co.,Ltd.

- 회 사 명 • 와이엠티(주)
- 설 립 일 • 1999. 02. 11
- 대 표 자 • 전성욱 (표면처리 기술사)
- 종 업 원 • 본사 152 (한국 : 142명 / 대만 10명)
- 소 재 지 • 인천광역시 남동구 남동동로 153번길 30
- 자 본 금 • 3,703백만원
- 주요제품
 - PCB 화학소재
 - 전자소재 분야
 - 표면처리외주도금[YPT]
- 주요시장
 - 모바일용 기판 및 모듈
 - 무선충전기용 모듈
 - Auto mobile 용 전장 부품
 - 바이오 센서 등

계열사 현황

YMT Shenzhen

- PCB 화학소재 중국 판매 법인
- 심천에 위치하고 있으며, 중국 및 대만계열 고객사 확보

YMT Taiwan Branch

- PCB 화학소재 대만 판매지사
- Taoyuan 위치, 대만에 위치한 PCB 본사 영업

YMT Vina

- PCB 화학소재 판매 및 제조법인
- 박닌,빈푹성 위치, 도금 외주사업 시행 예정. 1Q.2019

YPT

- 금도금 및 동도금 표면처리 외주 법인
- 안산에 위치, 한국 No.1 표면처리 외주 회사

Beyond Solution

- PCB용 장비 제조 및 판매

		주요 제품군	Function	주요 고객사	매출비중(2Q.18)
Chemical	Finish Plating [금도금약품]	- FPCB 금도금 - RFPCB 금도금 - 카메라모듈 도금	- PCB 표면 실장부위 산화방지 - SMT 신뢰성 향상 (모듈연결)	- ZDT, Career - 삼성전기, 비에이치, 영풍전자 등	44.1%
	Copper Plating [동도금약품]	- 전기동 - 무전해 화학동	- 적층회로 연결 - 동의 두께 조절로 회로 hole 외벽 도금 및 Via-fill 도금	삼성전기, 비에이치, 영풍전자, 인터플렉스 등	20.2%
	Process[공정약품]	- 박리제 - 에칭제 - 세정제 등	- DES 공정약품(회로형성) - PCB 전반 공정에 걸친 약품 보유 - Display, 반도체 약품 등	대덕GDS, 심텍 등	10.7%
Plating Outsourcing	Gold Plating [금도금외주]	- FPCB / RFPCB 외주 도금 - 카메라모듈 도금	RFPCB / 카메라모듈 외주 금도금 (고객사 공정 일부 대체)	대덕전자, 엘지이노텍 등	19.5%
	Copper Plating [동도금외주]	- 무전해 화학동 - Via-Fill 도금	- 하이엔드 동도금, VIAFILL 도금 - 전공정 외주	영풍전자, 비에이치, TLB 등	
Materials/Facility	Electronic Materials [전자재료]	- Copper foil - RTR 도금 - CCL 등	- 극동박(Ultra thin copper foil)을 이용한 차폐재, SLP용 동박 등 - 도금 기술을 이용한 전자 소재	Global 화학/소재 회사	-
	Facility&상품	- 자동공급기 - 화학동 장비 - 유지보수 등	- 고객사 양산 라인 금도금, 화학동도금 자동공급기 - 도금라인 유지보수,중고설비,제작	PCB 제조사	5.5%

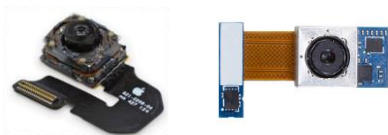
Finish Plating chemical

Soft ENIG Process



- ✓ FPCB / RFPCB 전용 금도금 프로세스
- ✓ 글로벌 M/S 및 기술력 1위
- ✓ 초 미세회로 구현 가능
- ✓ 삼성전자, 애플 제품 탑재

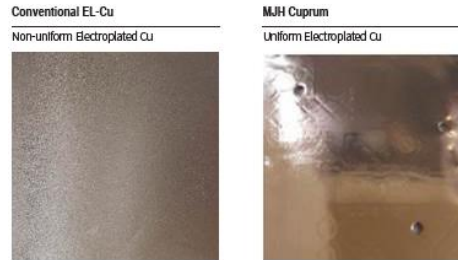
ENEPIG Process



- ✓ 카메라 모듈등에 적합한 미세회로 최종 표면처리
- ✓ 글로벌 Top tier 점유율 확보
- ✓ 원가경쟁력 및 기술경쟁력 확보

Copper plating chemical

Electroless Copper plating



- ✓ RA / HA 동박 전용 화학동도금 프로세스
- ✓ 경쟁사 대비 외관 품질 매우 우수

VFBJ series

- ✓ 모듈의 증가로 PCB가 경박단소화에 따라 고밀적 회로 및 적층에 대한 니즈 증가
- ✓ 이로 인해 고사양 VIAFILL 프로세스 채택 고객사 증대
- ✓ 기존 100% 외산시장에 현재 진입하여 점유율 확대중

Ultra-thin copper foil

Peelable Copper Foil: 1 ~ 2um



- ✓ 알루미늄 캐리어를 이용하여 특허분쟁을 피해 극박개발 성공
- ✓ 현재 유수의 PCB제조사 및 소재회사와 함께 Test 진행 중



[다양한 Application]

- ✓ MSAP, SAP 용 동박
- ✓ EMI 차폐, 방열용 동박
- ✓ FCCL 동박 등

OLED RFPCB 관련 매출 증대

• 3분기 OLED용 RFPCB 관련 매출 증대

- ✓ 아이폰 XS/XS MAX 2종의 OLED 패널 탑재에 따라, 해당 물량에 적용되는 당사 화학소재 매출 확대
- ✓ 단, RFPCB가 기존 아이폰X의 2개 모듈(Display Flex, TSP)에 적용되었던 것과는 달리, XS/XS MAX에서는 Display Flex에서만 적용되어 고객사 감소
- ✓ 한편, TSP용 FPCB가 MFPCB로 전환되면서, MFPCB를 생산하는 중국 고객사에 대한 당사의 화학소재 매출 증대

해외 시장 동도금 매출 확대

• 중국, 베트남 진출 한국 고객사 내 당사 점유율 증대

- ✓ 중국에 진출한 국내 PCB 제조사들에 대한 당사 동도금 약품 공급 시작
- ✓ 생산거점이 한국 → 베트남으로 이전함에 따라 베트남 주재 고객사에 대한 당사 동도금 매출 확대 중

• 해외고객사 동도금 라인 적용

- ✓ 대만 고객사의 동도금 라인에 당사 제품 적용 시작
- ✓ 해외 PCB 제조사들에 대한 당사의 동도금 약품 신뢰성 입증

YPT(기판외주가공) 실적감소

• 전년대비 국내 PCB 고객사의 물량 감소

- ✓ 갤럭시 S9, 갤럭시 노트9 등의 프리미엄 폰 뿐만 아니라, 전체적인 국산 모바일폰의 출하량 감소
- ✓ 이에 따른 국내 PCB 생산수량의 감소로 인하여 외주업체인 YPT의 실적 감소

• 국내 카메라 모듈 생산감소

- ✓ 휴대폰 시장의 침체와 더불어 중국 카메라 모듈업체로 물량이 이전됨에 따라 국내 카메라 모듈 시장 감소 → 관련 외주물량 감소
- ✓ '19년에는 해외이전 물량이 국내 카메라 모듈업체로 회귀할 예정에 따라, YPT의 실적 또한 개선될 전망

• Via-Fill 외주 양산의 Delay

- ✓ Via-Fill Line에 대한 양산 테스트가 진행 중이며, 당초 예상보다 PKG용 신뢰성 테스트 기간이 길어짐
- ✓ 현재 4Q 내 양산예정으로, 동도금 외주 양산이 시작될 경우 YPT의 실적 개선 전망

- 아이폰 XS 판매량 Risk 존재

- ✓ 아이폰 XS의 경우, RFPCB 관련 매출이 4분기까지 지속되었으나, 애플이 고가격 정책을 채용함에 따라 판매량 감소 Risk 존재
- ✓ 애플의 판매량에 따라 당사의 Main 고객사들의 물량이 크게 좌우될 것으로 전망

- 북미 고객사 액세서리 PCB 매출 발생

- ✓ OLED용 RFPCB가 아닌, 액세서리 및 Laptop용 매출 가시화
- ✓ 모바일과 연동되지 않는 Steady한 매출발생을 예상하고 있으며, 액세서리에 대한 인기가 늘어나는 만큼 새로운 시장의 매출확대 기대

- 동박 (소재) 양산 예정

- ✓ EMI Shield 용 동박 양산 계획을 수립 중에 있으며, 4분기 test 양산, 2019년 1분기 본 양산을 목표로 하고 있음
- ✓ 당사 개발 극동박 외에도 중국 C사와 Agents 계약을 맺은 일반 FCCL 및 CCL용 동박에 대한 Sample test를 현재 유수의 한국 PCB 제조사와 진행하고 있으며, 매출이 가시화됨에 따라 Slitting, 클린룸 설비 개선을 완료

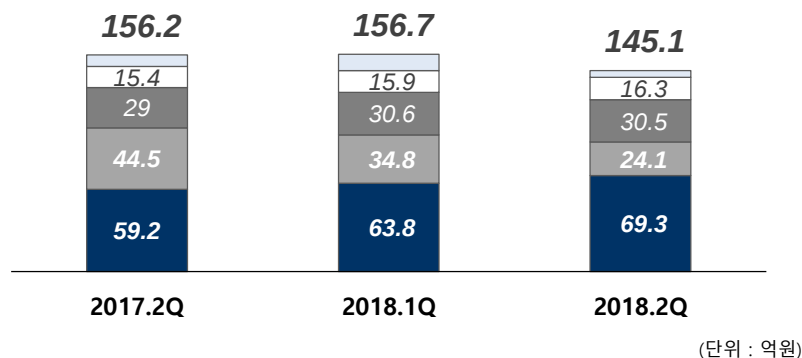
- 와이피티(기판외주) 물량의 회복

- ✓ FPCB, 일반 PCB용 금도금에 대해선 전망이 밝지 않으나, 카메라모듈용 PCB는 증가 추세
- ✓ 4분기 동도금 Via-Fill 외주 양산이 시작됨에 따라 19년은 올해 대비 실적 개선 전망

2018년 반기 사업성과 및 손익계산서

분기 및 사업별 매출 현황

■ 최종표면처리 ■ 기판가공 ■ 동도금 □ Process Chemical □ 기타



	2017.2Q	2018.1Q	2018.2Q
Total	156.2	156.7	145.1
최종표면처리	59.2	63.8	69.3
기판가공	44.5	34.8	24.1
동도금	29.0	30.6	30.5
Process Chemical	15.4	15.9	16.3
기타	8.1	11.6	4.9

1H.2018 손익계산서

(단위 : 억원)

	1H.2018	1H.2017
I. 매출액	301.7	287.5
II. 매출원가	192.9	177.7
III. 매출총이익	108.8	109.8
IV. 영업이익	46.5	56.2
기타수익	4.7	4.2
기타비용	7.9	5.4
금융수익	10.5	1.8
금융비용	6.8	34.0
V. 법인세차감전순이익	47.0	22.8
법인세비용	10.0	11.5
VI. 반기순이익	37.0	11.3
지배기업소유주지분	26.8	3.0
비지배지분	10.2	8.3

END OF DOCUMENT

감사합니다.